

第一回プリント基板めっき技術セミナー in Kawasaki

開催日時	2015年5月29日(金) 9時～17時30分(受付 8時30分～)
場所	ホテルKSP (神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1) 3階ホール「曙」

プログラム

※スケジュール、タイトルは諸事情により変更される場合がありますのでご了承ください

8:30～9:00

受付

9:00～9:05



ご挨拶 代表取締役社長 ジュリアン・ベイショア

9:05～9:35



マクダーミッド社の技術概要

担当: Joseph J. D'Ambrisi, Vice President - Electronics Solutions
通訳: 鷹取 哲生

9:35～10:05



基板表面銅厚低減を可能にする最新ビアフィルめっき技術

講師: Jim Watkowski, Director of Metallization Technologies
通訳: 三上 泰弘

10:05～10:20

休憩 (休憩中、展示コーナーをご覧ください)

10:20～10:50



基板厚変化に対応したスルーホールフィリングめっき

講師: Jim Watkowski, Director of Metallization Technologies
通訳: 前田 義浩

10:50～11:20



MID (Molded Interconnect Devices)

講師: Lenora Toscano, Director of OEM Applications
通訳: 渡邊 歳哉

11:20～12:05



IoT、M2Mにおけるモジュール実装技術のご紹介
特別講師: 株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社
システム・ソフトウェア推進センター システム実装技術担当
八南谷 明彦

12:05～12:50

昼食 (3階 ギャラリー 立食形式)

12:50～13:35



プリント基板の市場動向

特別講師: プリズマーク・パートナーズ シニア・コンサルタント
平坂 和雄

13:35～14:20



低エッチブラックホールプロセスの高難度基板への適用

講師: Jim Watkowski, Director of Metallization Technologies
通訳: 青木 正臣

14:20～15:00



ICパッケージ/ビルドアップ基板対応 セミアディティブプロセス先端技術

講師: Dr. Fei Peng, Senior Research Chemist
通訳: 安藤 直美

15:00～15:10

休憩

15:10～15:50



オキシド代替最新技術 高周波対応「M-Speed」のご紹介

講師: Steve Castaldi,
Director Electronics Specialties - Electronics Solutions
通訳: 三上 泰弘

15:50～16:20



サプライチェーン戦略 - OEMとのさらなるコラボレーションをめざして

講師: Lenora Toscano, Director of OEM Applications
通訳: 鷹取 哲生

16:20～17:30

ラボ・ツアー (C棟8階)

18:00～

親睦会 受付17:30～ (3階 KSPホール「光」)

日本マクダーミッド株式会社

TEL 044-820-1181 FAX 044-812-4485 E-mail Japan.sales@macdermid.com
申込方法: <http://macd.co.jp/speaker-schedule>